

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】令和 1 年 11 月 21 日 (2019.11.21)

【公開番号】特開 2017-92464 (P2017-92464A)  
 【公開日】平成 29 年 5 月 25 日 (2017.5.25)  
 【年通号数】公開・登録公報 2017-019  
 【出願番号】特願 2016-214727 (P2016-214727)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 0 1 D

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 10 月 11 日 (2019.10.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 4】

特定のタイプの半導体パッケージでは、種々の半導体ダイが「積み重ねられたダイ」の構成で配置される。そのようなパッケージでは、それらのダイのうち 1 若しくはそれ以上が他のダイ（またはスペーサー、基板など）から張り出す場合がある。図 1 は、そのようなパッケージを例示したものである。図 1 において、下側の半導体ダイ 102 は、基板 100 により支持されている（ここで、ワイヤーループ 108 が、ダイ 102 上のボンディング位置と、基板 100 上の別のボンディング位置との相互接続をもたらしている）。スペーサー 104 は、下側の半導体ダイ 102 と上側の半導体ダイ 106 間に配置される。上側の半導体ダイ 106 は、スペーサー 104 および下側の半導体ダイ 102 から張り出し、当該スペーサー 104 および半導体ダイ 102 に支持されていない部分を含む。そのため、上側の半導体ダイ 106 は「オーバーハングダイ」（張り出したダイ）と呼ばれることがある。

この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある。

（先行技術文献）

（特許文献）

（特許文献 1） 米国特許第 7, 762, 449 号明細書

（特許文献 2） 米国特許第 7, 699, 209 号明細書

（特許文献 3） 米国特許第 5, 566, 876 号明細書

（特許文献 4） 米国特許第 8, 302, 840 号明細書

（特許文献 5） 米国特許出願公開第 2012 / 0074206 号明細書

（特許文献 6） 中国特許出願公開第 101740427 号明細書

（特許文献 7） 特開平 07 - 183321 号公報

（特許文献 8） 特開 2007 - 180349 号公報

（非特許文献）

（非特許文献 1） Search Report issued by China National Intellectual Property Administration in connection with related Chinese Patent Application No. 201610959217.4.